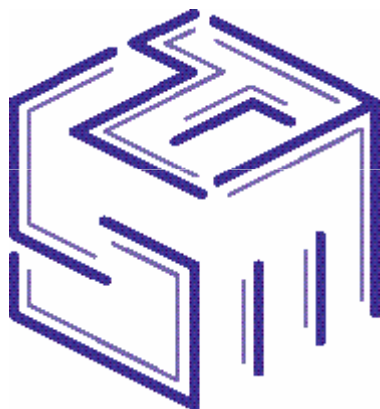




Tai Sol Electronics
Quality & Technology in Manufacturing



泰碩電子股份有限公司 (3338) 業績發表會



Tai Sol Electronics
Quality & Technology in Manufacturing

免責聲明

- 本資料由泰碩電子股份有限公司(以下稱「本公司」)製作，且未經獨立查證。本公司並未做任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本公司及其任何關係企業、顧問或代表人對於本資料中所呈現或包含之任何資訊造成的任何損失概不負責。本資料中所呈現或包含之資訊可不經通知加以變更，且不保證其正確性。本資料不構成證券發行邀約。
- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

業績發表會簡報

壹、公司概况

貳、產品研發及市場概況

參、經營績效

肆、意見交流

業績發表會簡報

壹、公司概况

貳、產品研發及市場概況

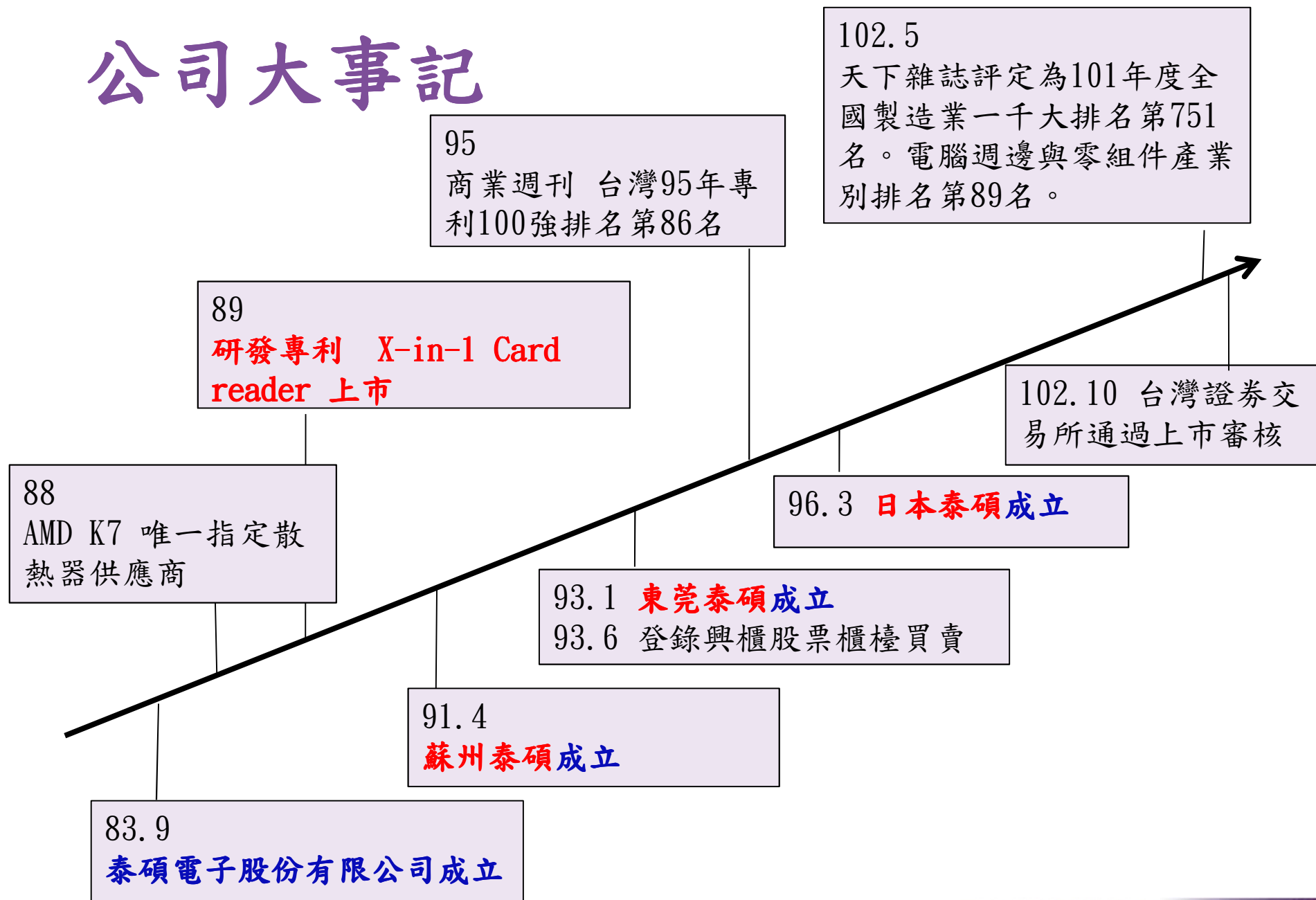
參、經營績效

肆、意見交流

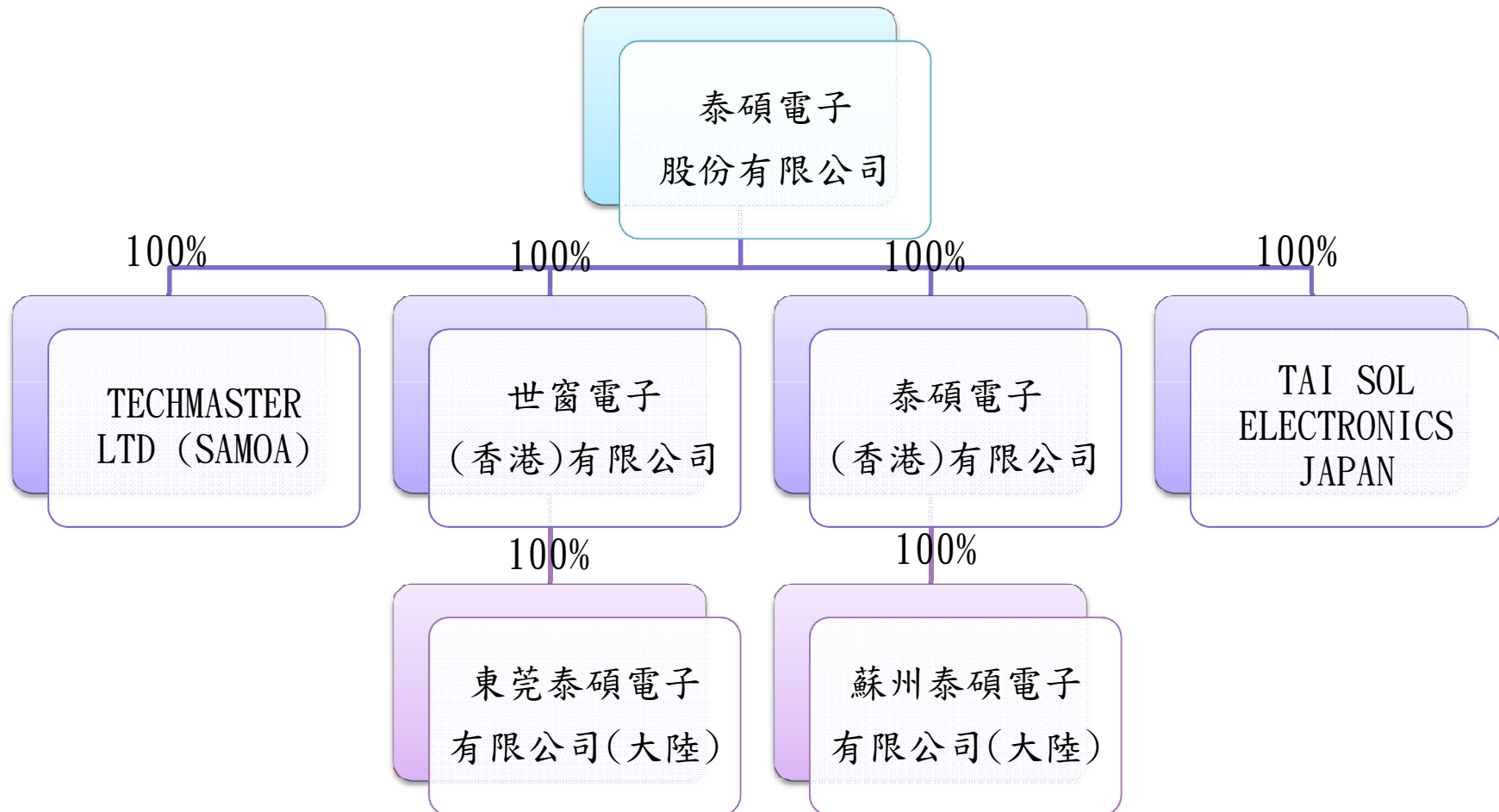
公司基本資料

股票代號	3338 泰碩電子股份有限公司
董 事 長	余清松
總 經 理	江玉國
成立日期	民國83年9月23日
實收資本額	新台幣6.2億（新股承銷後達新台幣6.98億）
主要產品	散熱器，連接器
101年集團營業額	新台幣28.9億元(102年至Q3 19.9億元)
集團員工人數	102/8/31：1,892人
公司地址	台北市內湖區瑞光路302號3樓

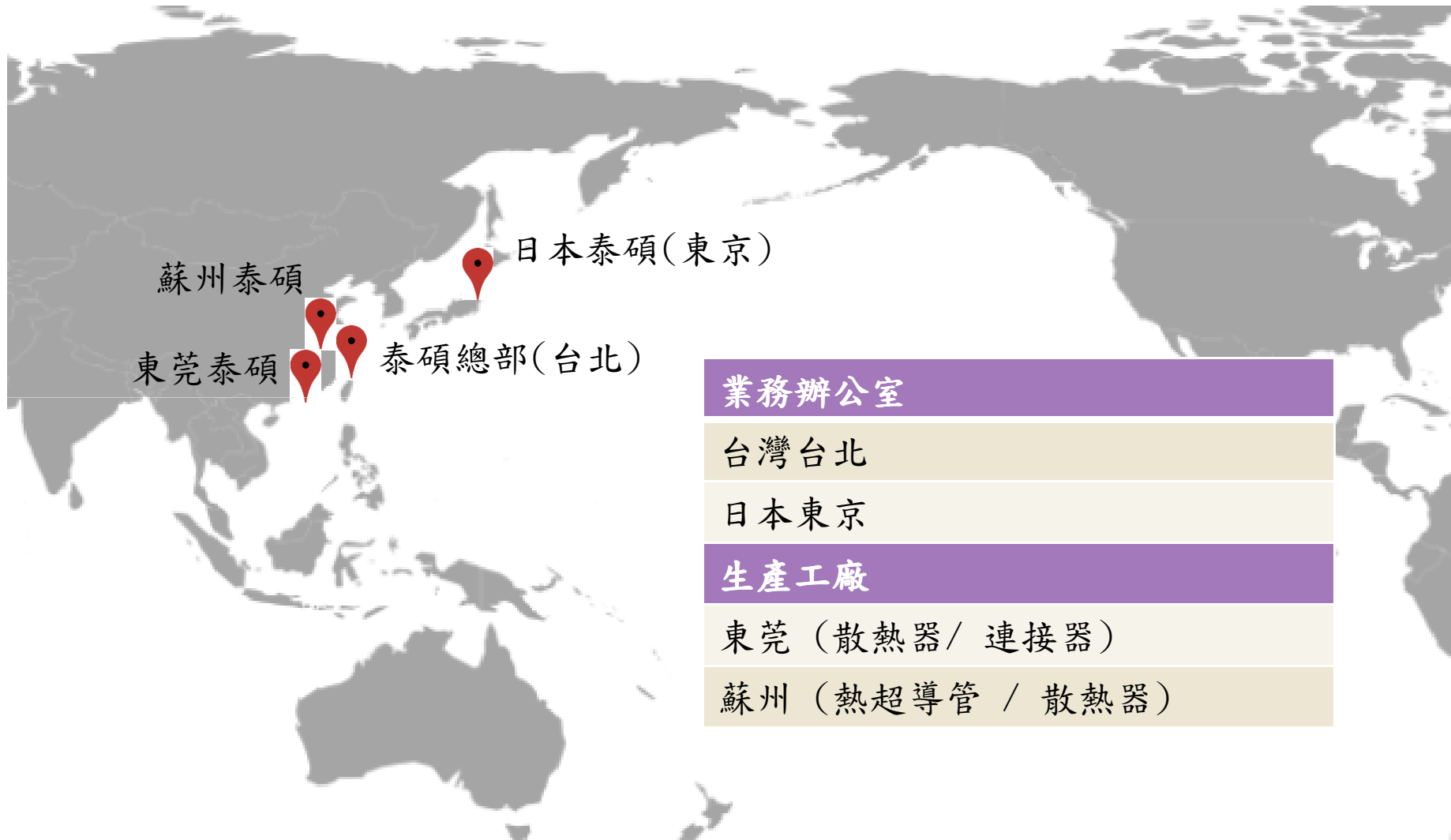
公司大事記



公司集團架構



公司分佈



業務辦公室

台灣台北

日本東京

生產工廠

東莞（散熱器 / 連接器）

蘇州（熱超導管 / 散熱器）

蘇州泰碩電子有限公司

主要產品	熱超導管 / 散熱器
員工人數	744人
設備	切割機，縮管機，高溫連續爐，除氣機， 全自動測試機，實驗設備
樓層面積	32,062平方公尺
認證	SGS/ ISO 9000，ISO 14000， TS 16949(認證申請中)



東莞泰碩電子有限公司

主要產品	散熱器 / 連接器 / 讀卡器模組
員工人數	1,347人
設備	迴鐸爐，射出成形機，半自動組裝機， 組裝流水線，沖床，實驗設備
樓層面積	67,055平方公尺
認證	SGS/ ISO 9000，ISO 14000



經營團隊

職 稱	姓 名	業 界 年 資	泰 碩 年 資	主 要 經 (學) 歷
總 經 理	江玉國	28	19	東海大學工業工程學系畢 台灣杜邦(DuPont)電子事業部業務經理
執行副總經理	賴耀惠	32	13	台北工專機械工程系畢 廣達電腦研發部協理
副 總 經 理	林孟逸	17	17	淡江大學日文系畢 台北官東公司業務經理
副 總 經 理	劉克平	17	13	國立台灣科技大學機械系畢 聯力工業機械工程師
協 理	盧文奇	15	8	國立清華大學動力機械系碩士 訊楊數位科技公司經理
副 總 經 理	曾倦祺	9	6	國立中山大學碩士班機械研究所畢 隆昕國際貿易業務副理
副 總 經 理	郭尚仁	11	4	國立中央大學太空科學研究所 百慕達商泰科資訊業務經理
副 總 經 理	吳崇文	19	3	國立交通大學機械工程系畢 朝貴鋼模工業副總經理
財 務 長	陳淑惠			國立中山大學財務管理學系 斐成企業稽核室副理
稽 核 主 管	蔡松諭			淡江大學會研所EMBA 全國電子股份有限公司稽核專員

業績發表會簡報

壹、公司概况

貳、產品研發及市場概況

參、經營績效

肆、意見交流

產品組合

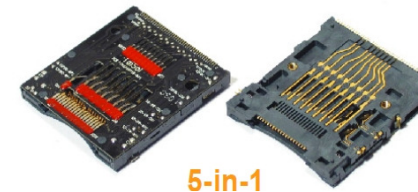
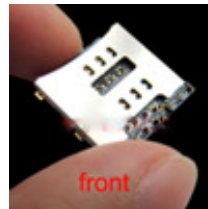
• Thermal Solution



• Heat Pipe



• Connectors

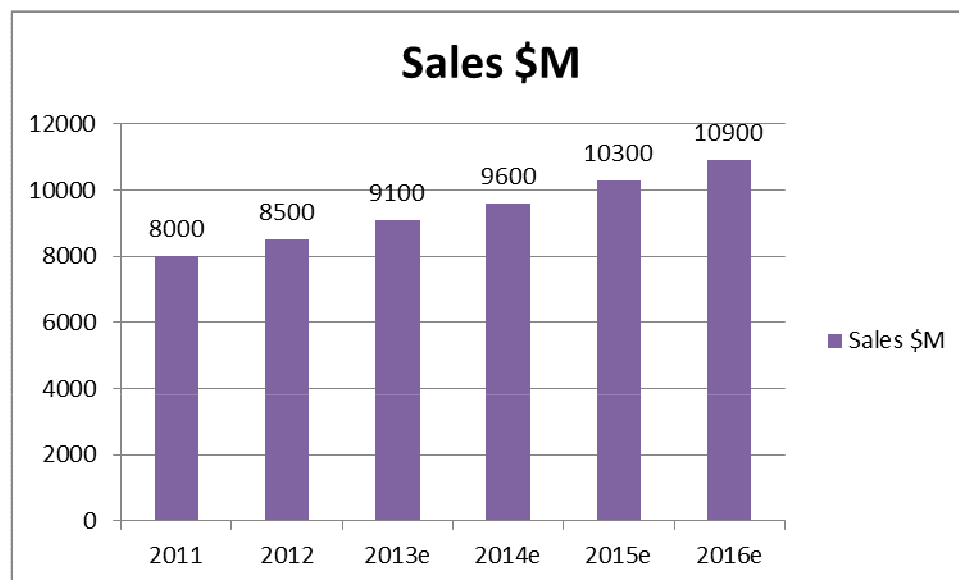


• Modules



市場分析

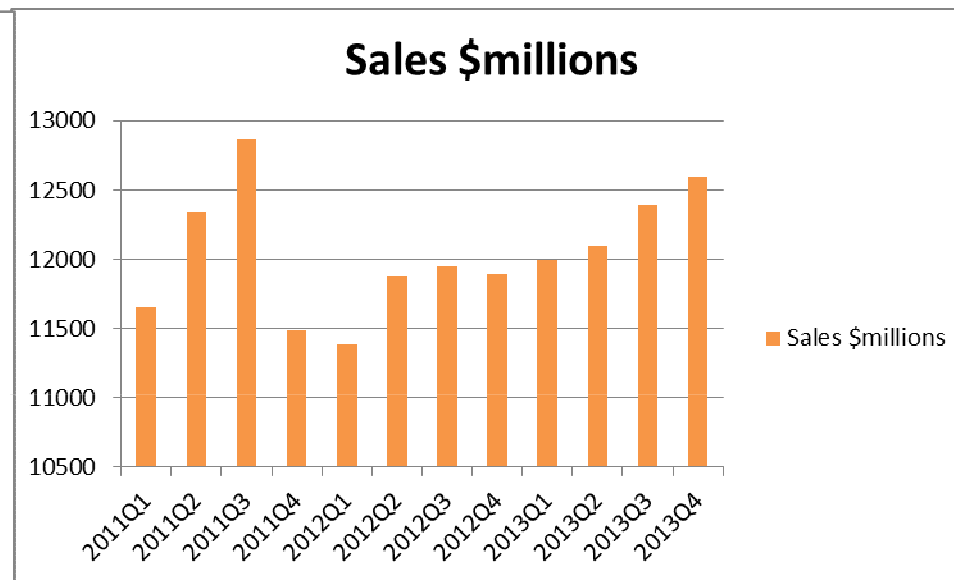
散熱市場全球產值預測



資料來源：BBC research

- 電子產品輕薄小性化，散熱功能重要
- 雲端伺服器散熱需求
- LED燈，通訊設備及電動車

連接器全球產值預測



資料來源：Bishop research

- 電子產品輕薄小性化，連接器微型化
- 大量資料傳輸需求，連接器高速化
- 生活應用需求，連接器生活功能化

市場分析

-產品應用趨勢

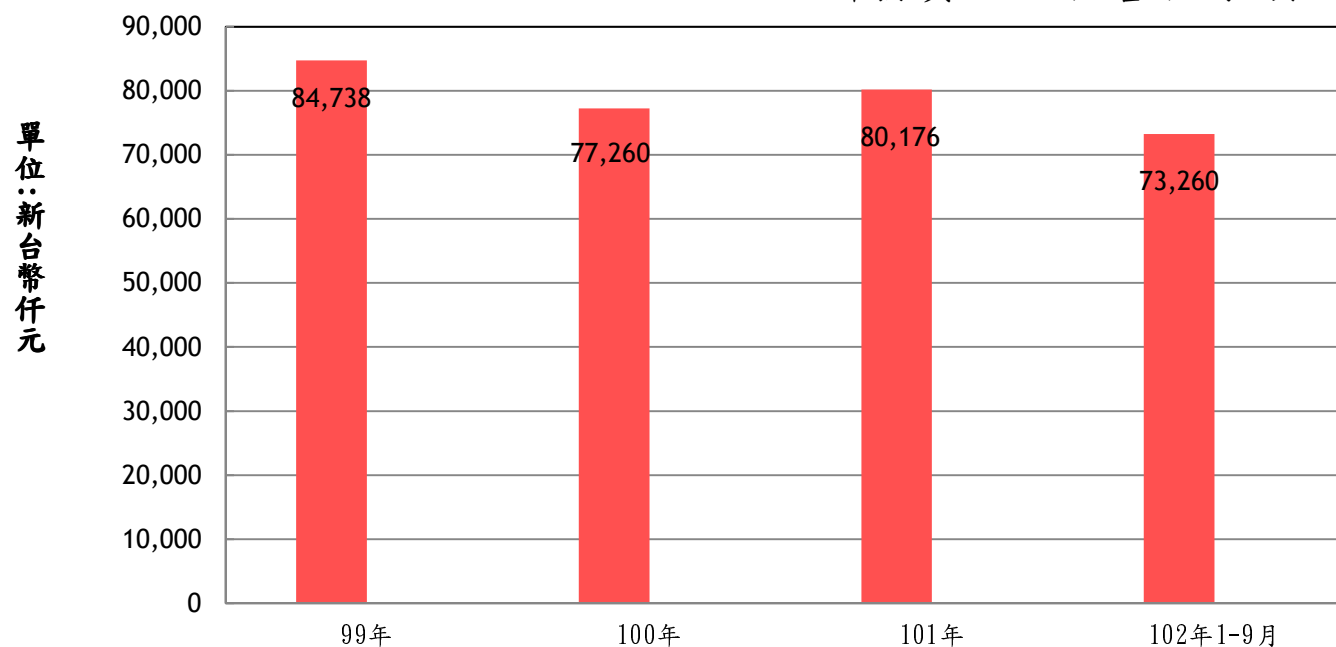


競爭優勢

- 優異研發創新能力與眾多專利
 - HP Printer
 - ALPS
- 自主開發製程能力及持續改善能力
 - 二次嵌入式射出成型
 - 熱管除氣機 / 自動定量給粉振粉機
- 與產業龍頭合作，掌握前期先進技術材料及新產品市場規格
 - 神戶製鋼 / 住友
 - SD4.0

研發投入 與 專利

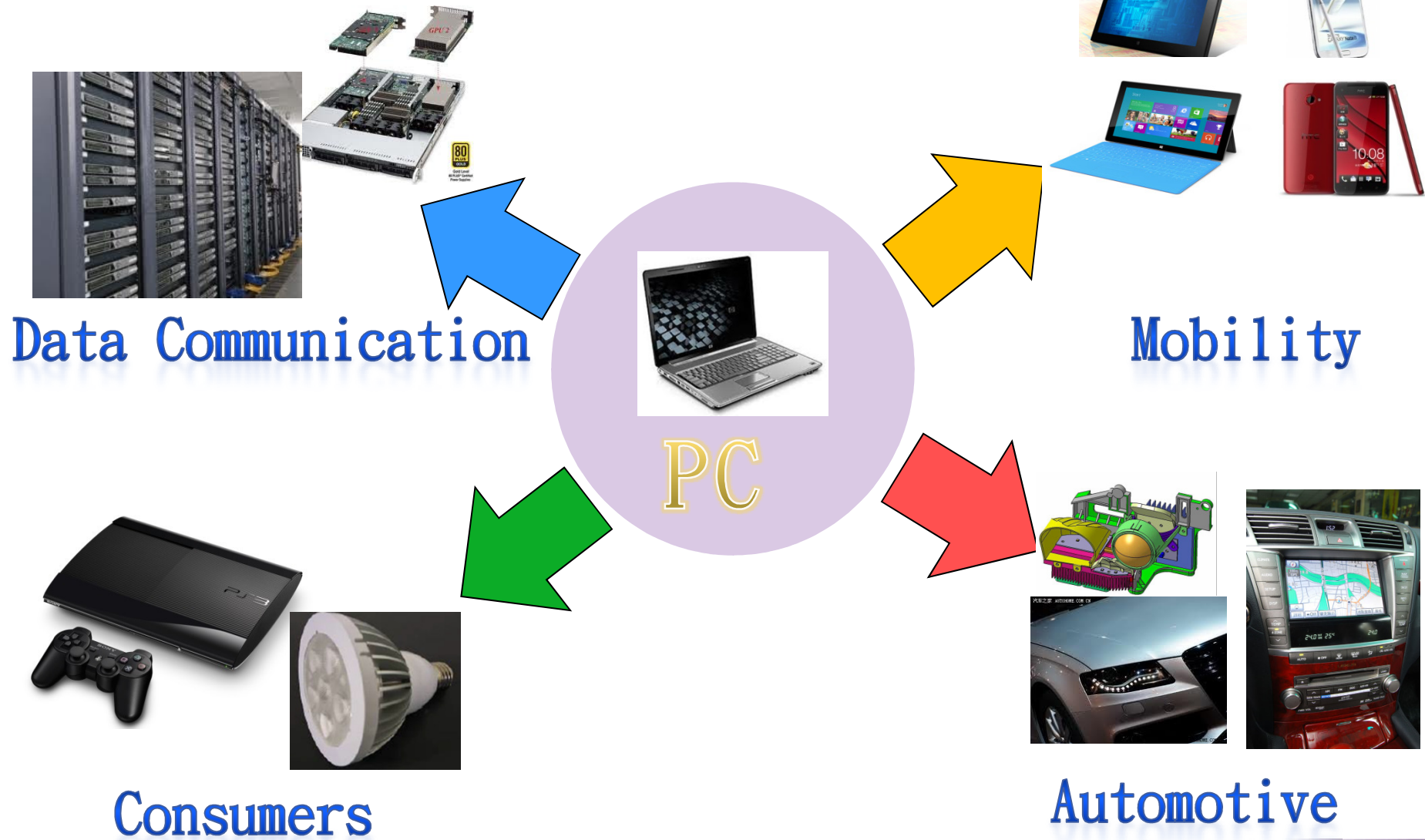
研發費用及占營收淨額比例



研發費用	84,738	77,260	80,176	73,260
研發費用占營收淨額比例	3.74%	2.81%	2.77%	3.67%

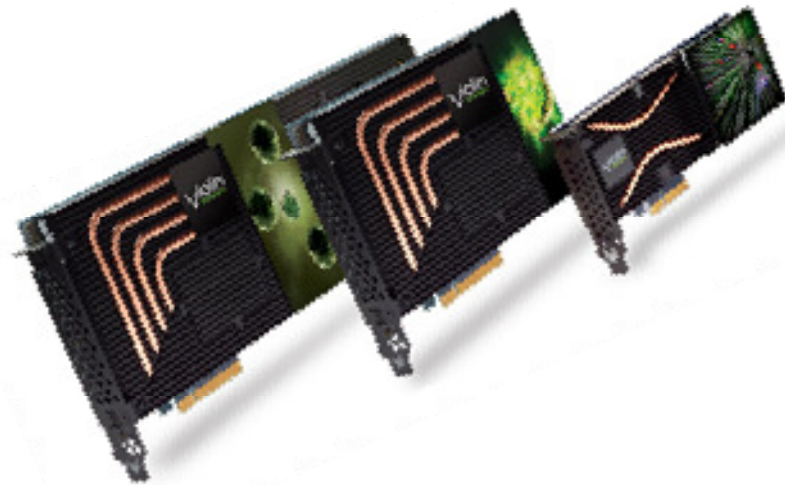
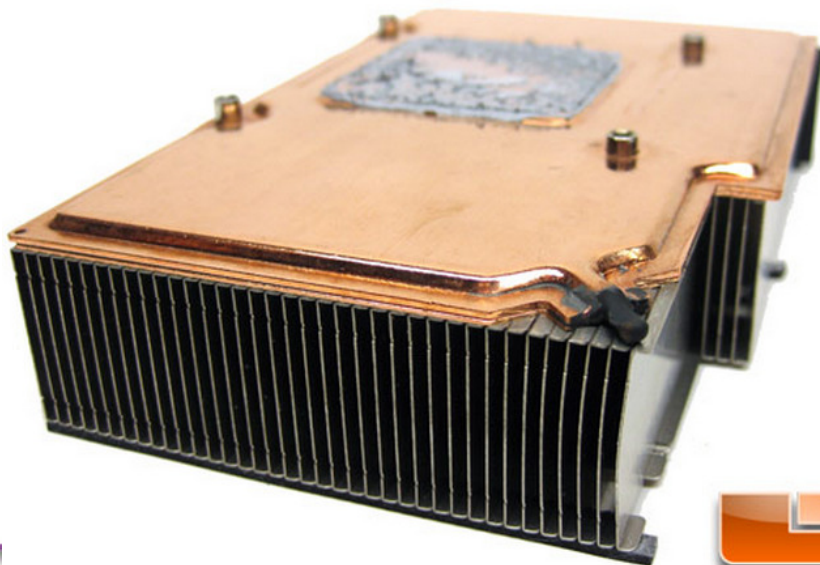
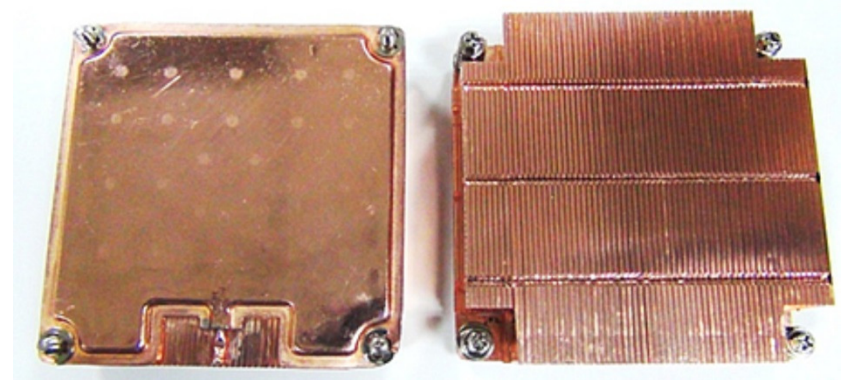
主要技術來源為自行研發；目前本公司共擁有有效國內外專利274件。（其中連接器194件、熱傳導77件及其他3件）

行銷發展佈局

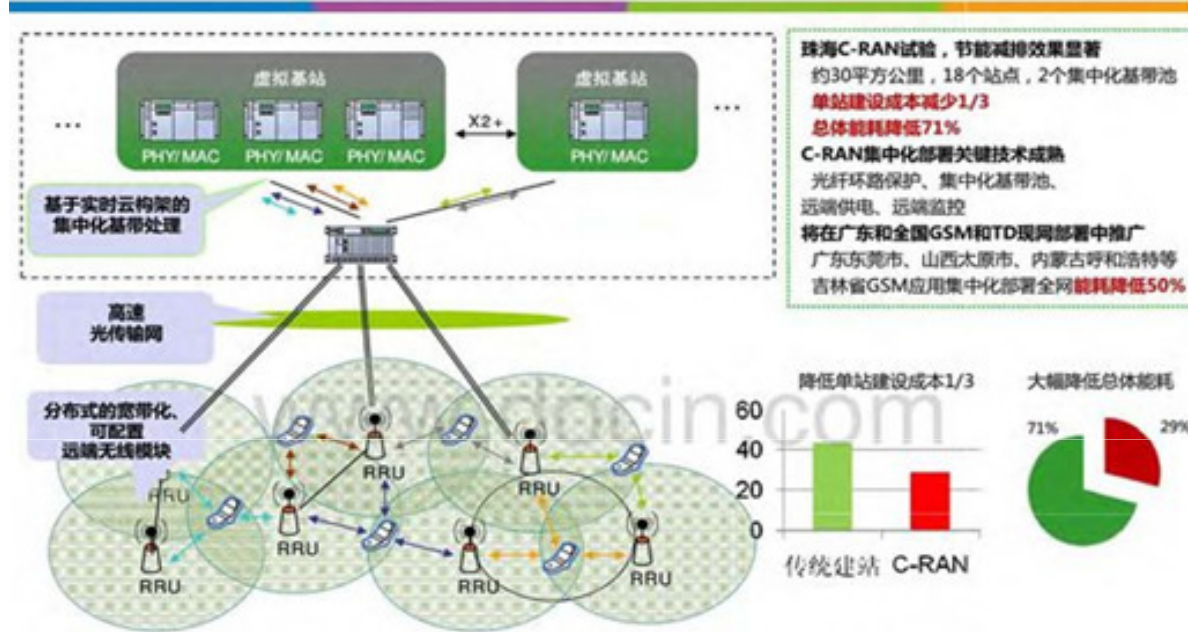
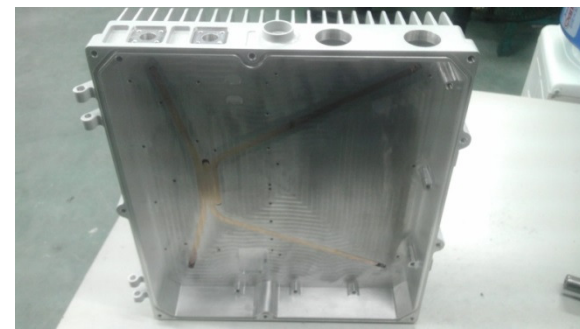
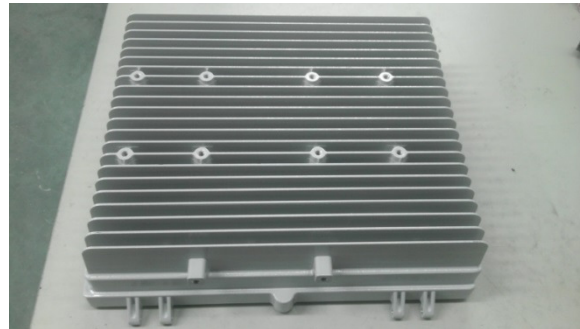


Cloud Computing

- 現有熱超導管技術。
- 預計今年底完成產能準備。
- 既有客戶群
- 應用
 - Vapor Chamber for CPUs
 - Slim Heat pipe for PCIE and DDR



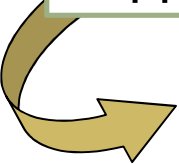
Data Communication



Consumers



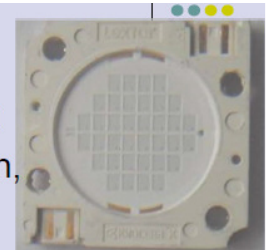
- Product : Common Interface (CI)
- Application : Smart TV

- 
- Product : Common Interface (CI2)
 - Application : Smart TV

二次嵌入式射出技術並與日本公司合作
開發LED COB 支架

3160-LB15

- Light ball, Length and width is 15cm
- Environmental protection, low-carbon, higher color, higher bright
- Application: TV&NB



Tai Sol Electronics
Quality & Technology in Manufacturing

Consumers

- Product : PS3 Thermal Module
- Application : Game Machine

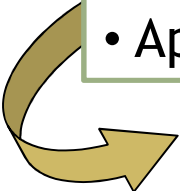
- 
- Product : PS4 Heat pipe
 - Application : Game Machine



Consumers



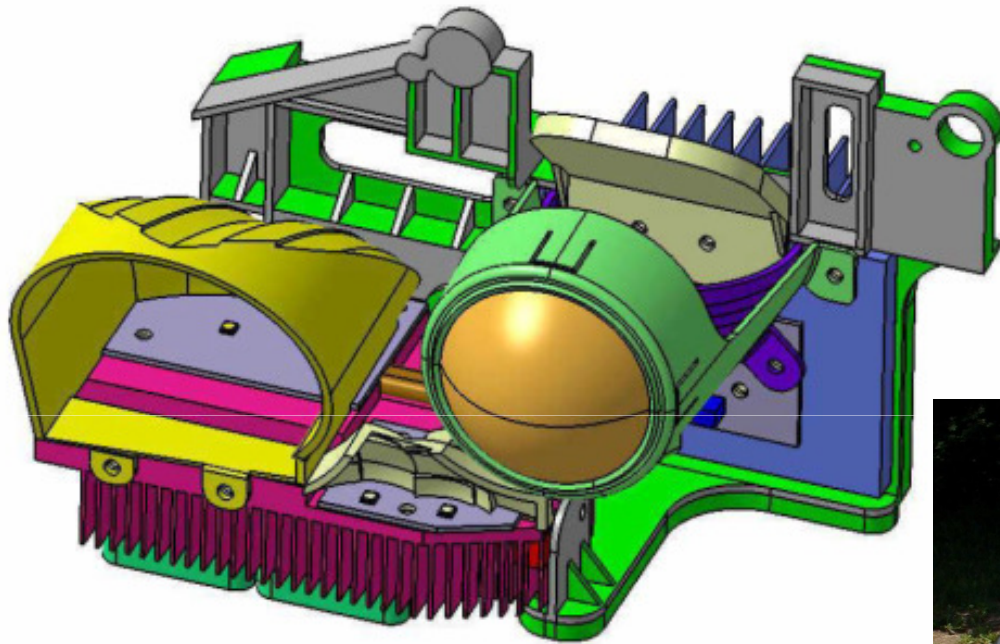
- Product : XBOX 720 Heat pipe
- Application : Game machine

- 
- Product : XBOX ONE Heat pipe
 - Application : Game machine

MOBILITY



Automotive



鎂合金沖壓產品. 新鋁合金板材

• 鎂合金沖壓產品

- 引進日本領先技術，於中國蘇州合資設立生產工廠，技術門檻高。
- 產品重點在於重量輕、結構強、抗輻射。應用在薄形NB、平板、手機，未來更有機會應用在建築/醫療。

• 新鋁合金板材

- 日本領先製程板材，
- 產品重點在於外觀更均勻有光澤、結構強。
- 應用在薄形NB、平板、手機。

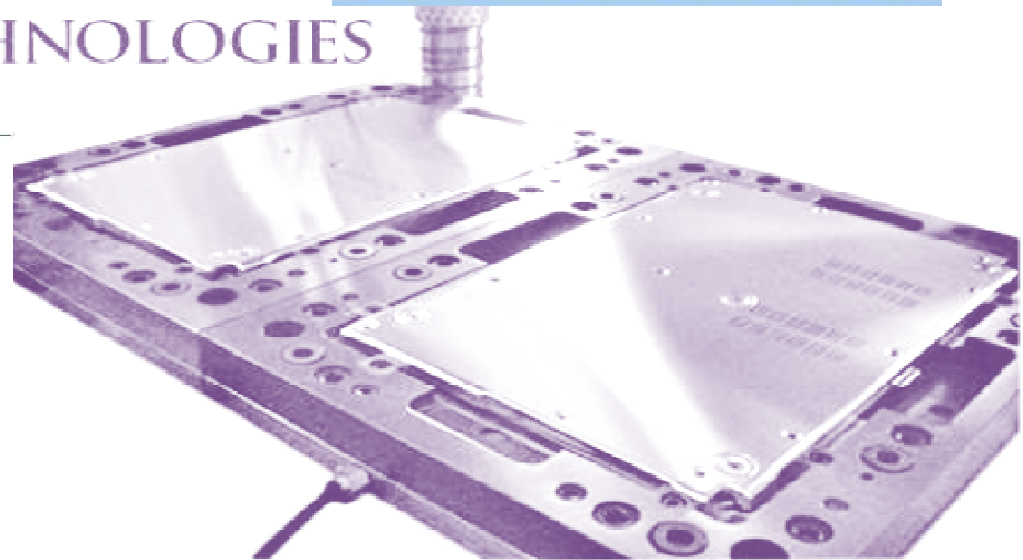
First in the World!

Mass Production Press Forming of
Magnesium-lithium Alloys (Mg-Li Alloys)

[Learn more](#)



Mass Production Press Forming of a Magnesium Alloy (AZ31) for a Variety of Products



業績發表會簡報

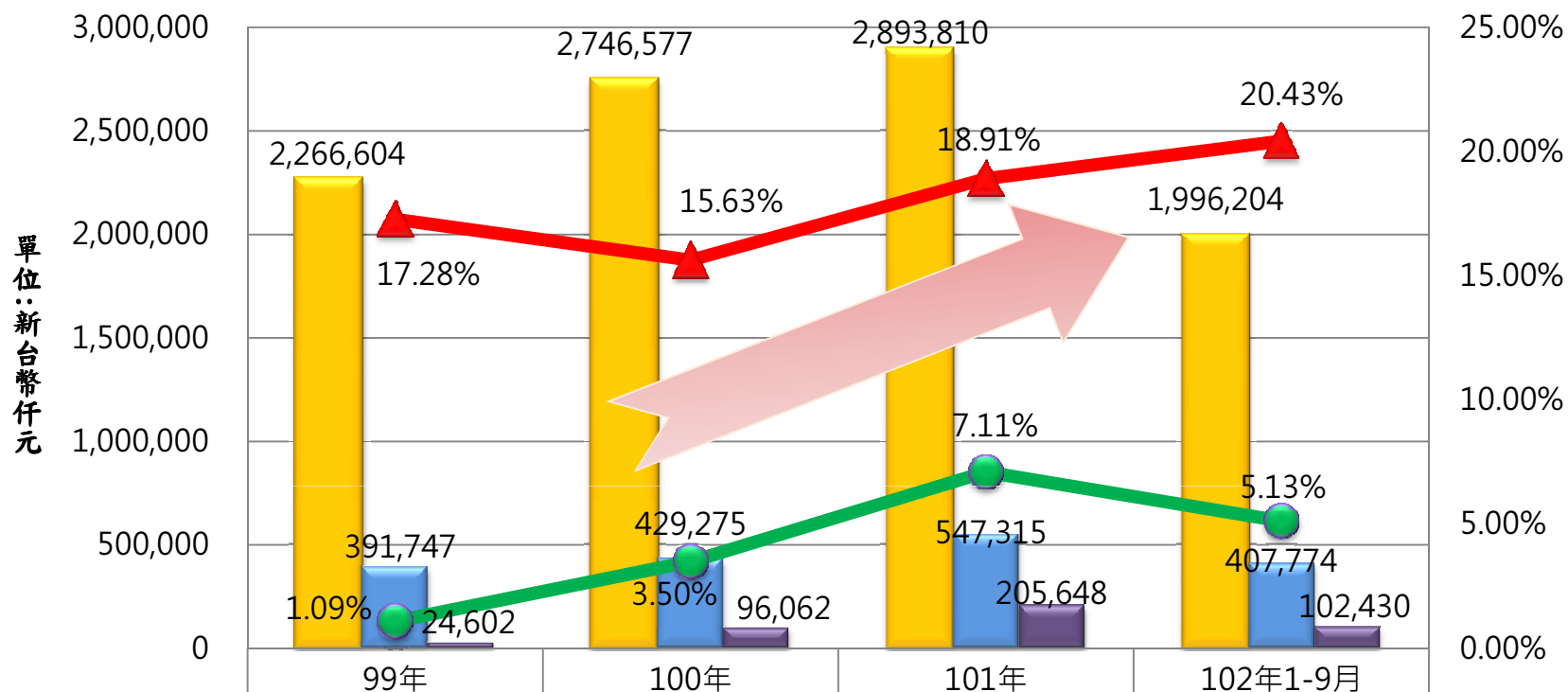
壹、公司概况

貳、產品研發及市場概況

參、經營績效

肆、意見交流

營收 與 毛利



	銷貨淨額	2,266,604	2,746,577	2,893,810	1,996,204
	營業毛利	391,747	429,275	547,315	407,774
	營業淨利	24,602	96,062	205,648	102,430
	毛利率	17.28%	15.63%	18.91%	20.43%
	營業淨利率	1.09%	3.50%	7.11%	5.13%

競爭優勢－經營管理

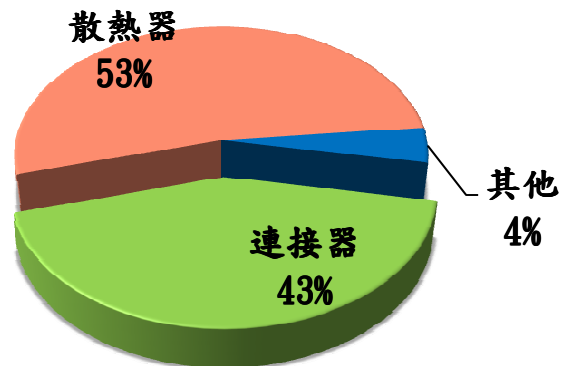
分析項目		泰碩 2013/Q2	雙鴻 2013/Q2	力致 2013/Q2	緯翔 2013/Q2	詮欣 2013/Q2
經營能力	應收款項週轉率(次)	3.39 ②	4.73①	2.36⑤	2.64④	3.35③
	平均收現天數	108 ②	77①	155⑤	138④	109③
	存貨週轉率(次)	7.78 ②	6.65④	—	7.36③	9.45①
	平均銷貨天數	47 ②	55④	—	50③	39①
	固定資產週轉率(次)	7.75 ②	5.77③	2.95⑤	4.36④	11.74①
	總資產週轉率(次)	1.38 ②	1.40①	0.74④	0.71⑤	1.06③
資產報酬率	股東權益報酬率(%)	17.64 ①	0.20④	(6.82) ⑤	14.96②	11.26③
	營業利益占實收資本額比率(%)	24.31 ②	3.82④	(24.45) ⑤	36.51①	16.49③

資料來源：2012年各公司經會計師查核簽證或閱之財報報告，泰碩電子整理。

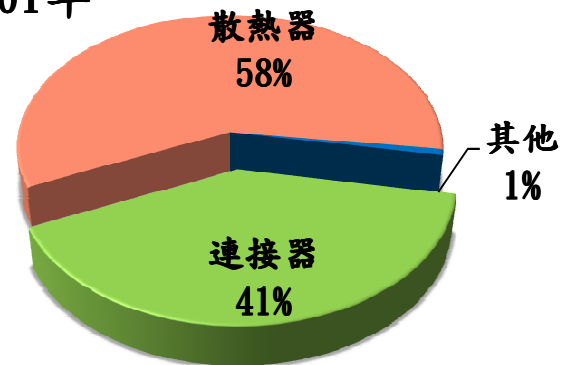
- * 平均收現天數及存貨週轉率皆不遜色於同業
- * 相較同業，泰碩具備較佳的資產報酬率

產品銷售比重

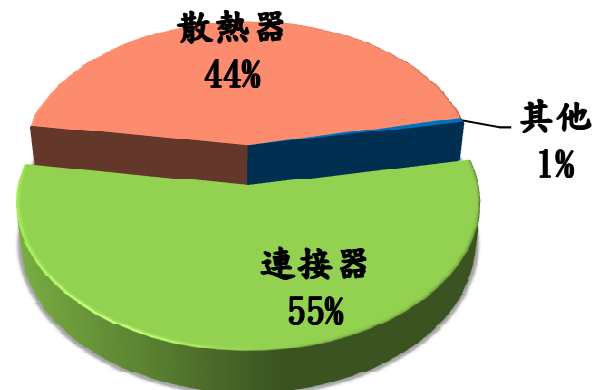
99年



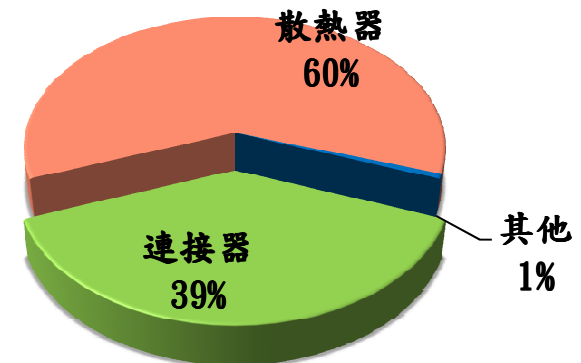
101年



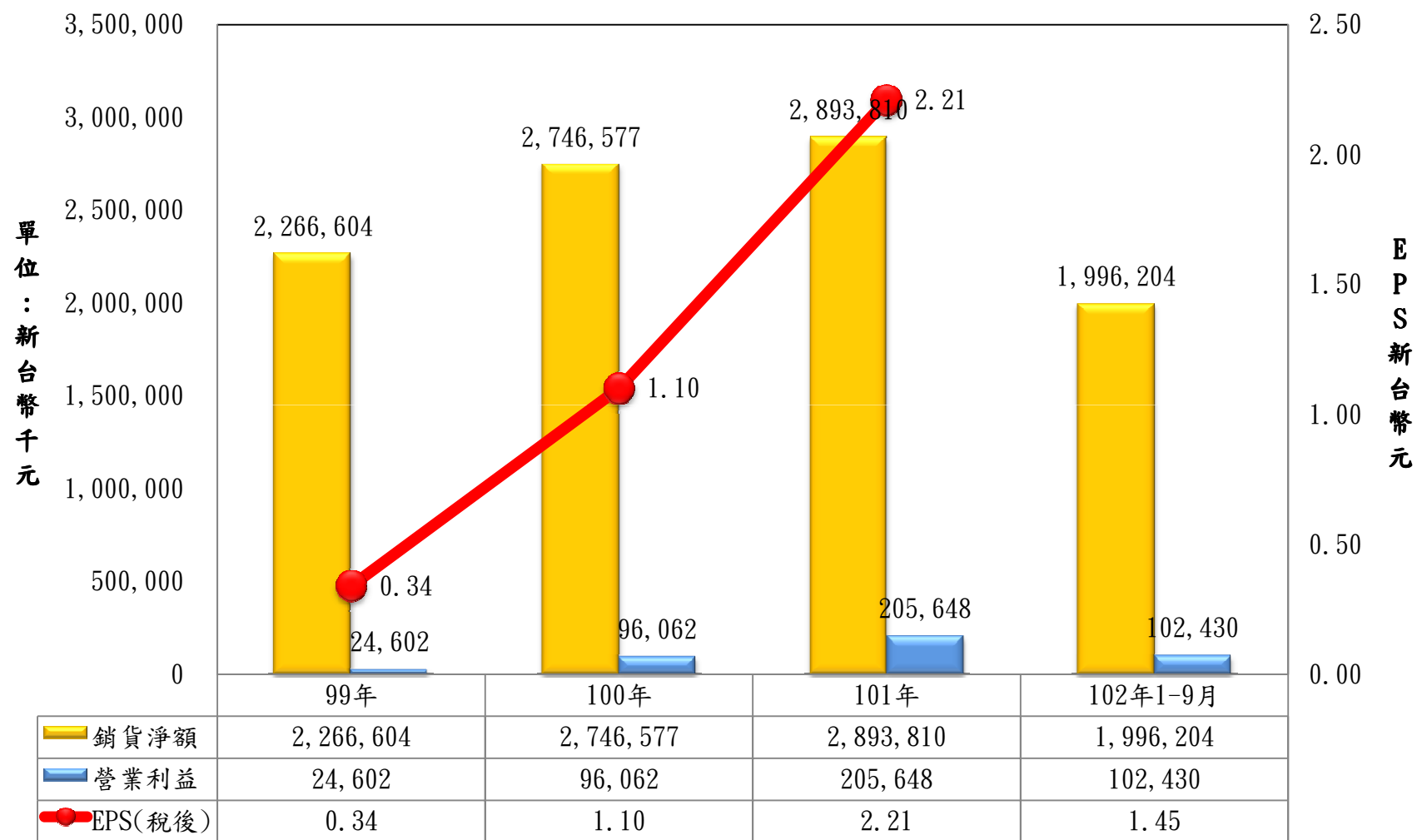
100年



102年1-9月



EPS



未來發展前景

－未來五年之主要成長動能

- － 散熱解決方案
 - Data communication (4G LTE)
 - Automotive (電動車)
- － 智慧讀卡機模組(行動商務)
- － 新產品事業體

敬請指教

泰碩電子股份有限公司
TaiSol Electronics Co., Ltd